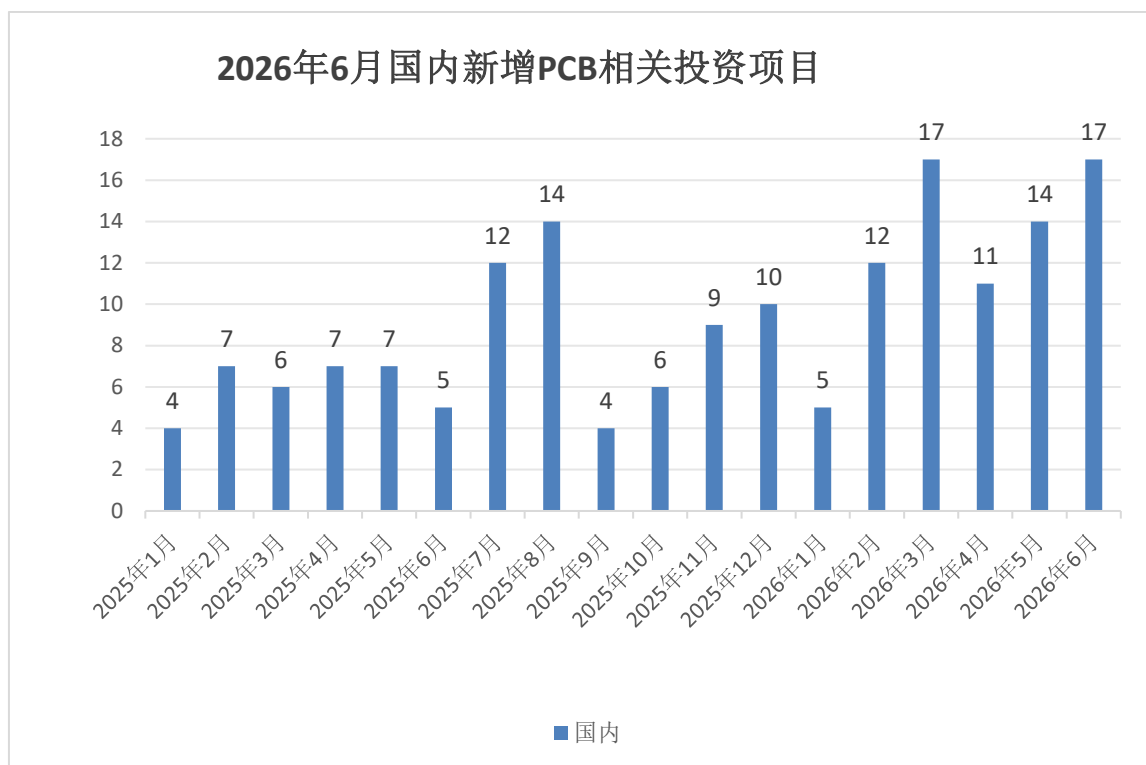


一、综述

2026 上半年，全球电子电路行业投资热度维持高位，国内扩产动能明显强于国际。上半年国内 PCB 投资呈项目数量与披露金额均大幅增加；国际方面，上半年项目数量有所回落、但单体项目金额扩大。全球投资热度仍由中国大陆扩产及 AI 算力、材料配套拉动，海外则以东南亚的增资、扩产以及再投资为主。

二、国内

国内投资，2026 年 1—6 月国内新增 PCB 相关投资项目合计约 76 项（2025 年同期 37），项目数量同比增长 105.4%。同期国内新增披露投资金额（包含立项、签约、收购及投融资等）合计约 1691 亿元人民币，金额同比 2025 年呈数倍级扩张。



产品结构上，本轮扩产由人工智能算力、高密度互连板、封装基板及上游材料共同拉动，以上市公司为主，且投资金额偏大。重点项目包括：广合科技东莞智造总部签约 60 亿元，并可转债投向云擎智造基地二期及高多层技改合计约 35.4 亿元；深南电路无锡 AI 算力电子电路项目总投资约 45.36 亿元；兴森科技珠海高阶 mSAP 及封装基板项目合计约 31.8 亿元；骏亚科技赣州高多层/HDI 项目 15.57 亿元；宏和科技黄石高性能电子材料产业园拿地总投约 80 亿元。

三、国际

国际方面，2026 上半年国际新增 PCB 相关立项合计约 31 项 (2025 年同期 47 项)，同比下降 32%，但披露金额投资快速增长

至约 790.6 亿元，主要是因为人工智能等科技领域发展导致单项目投资金额扩大。从区域看，投资主要集中于东南亚及欧美，动力源于 AI 算力与材料配套带动的企业再投资和扩产为主。

国际重点项目包括：AT&S 拟约 15—20 亿欧元扩建马来西亚 Kulim 高端 IC 基板及先进 PCB 产能；明阳电路槟城柏淡科技园智能化 PCB 制造基地（一期）约 23.3 亿元立项；LG Innotek 与越南海防签署封装基板厂扩建 MOU；名幸电子越南富寿安光厂约 5 亿美元开工；鹏鼎向泰国子公司增资约 14.8 亿元追投；TTM 拟收购瑞士、德国两家 PCB 公司等。

